## PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Arlikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Weigner	clobe Farmi	A POTITA (CO.
E 0707 WO	WEITERES	siene Formblai	it PCT/ISA/220 sowie, soweit nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	VORGEHEN		
Manual Antonzelonen	Internationales Anmeldedatu (Tag/Monat/Jahr)	m	(Frühestes) Prioritätsdatum
PCT/EP2004/051008	03/06/200	)4	(Tag/Monai/Jahr) 12/07/2003
Anmelder	00,00,200		12/07/2003
LEICA MICROSYSTEMS SEMICONDO	70700		
DESCRIPTION SEMICONDO	JCTOR GMBH		
Dieser internationale Recherchenbericht wur Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem In	de von der Internationalen Rei ternationalen Büro übermittelt	cherchenbehörde	erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umf	RRt Inscessmt 4	Blätter.	•
			Date to the second
		sencht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bel.
1. Grundlage des Berichts			
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die intern durchgeführt worden, in der sie einge</li> </ul>	nationale Recherche auf der G reicht wurde, sofern unter die	irundlage der inte sem Punkt nichts	rnationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.
Die Internationale Re Internationalen Anme	cherche ist auf der Grundlage idung (Regel 23.1 b)) durchge	einer bei der Beh führt worden.	rörde eingereichten Übersetzung der
<del></del>			d/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1
2. Bestimmte Ansprüche habe	en sich als nicht recherchier	bar erwiesen (sie	ehe Feld II).
3. Mangelnde Einheitlichkeit d	ler Erfindung (siehe Feld III).		
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	una		
X wird der vom Anmelder einge	<del>-</del>		
wurde der Wortlaut von der B			
	and do the longrissingessizi.		
•			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
X wird der vom Anmelder einger	eichte Wortlaut gegebmigt		
	_	ngegebonee Eee	sung von der Behörde festgesetzt.
Der Anmelder kann der Behör Recherchenberichts eine Stell	ue ilineinaid eines Monais nai	ch dem Datum de	r Absendung dieses Internationalen
6. Hinsichtlich der Zeichnungen			
a. Ist folgende Abbildung der Zeichnung	en mit der Zusammenfassung	zu veröffentliche	n: Abb. Nr. 4
X wie vom Anmelder vor			
	usgewähit, weil der Anmelder	selbst keine Abb	ildung vorgeschlagge het
	iusgewählt, weil diese Abbildu		
b. wird keine der Abbildungen mi			pesser Kerrizeichilet
	veror		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Januar 2004)

			PCT/EP2004/051008
Ī	A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06T7/00 G01N21/88	
ı			
		ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	· .
-		ICHIERTE GEBIETE	
	IPK 7	er Mindestprütstoll (Klassifikalionssystem und Klassifikationssymbole ) GO6T GO1N	
	Recherchler	le aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die rec	herchierten Gebiete fallen
Ī	Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank un	d evtl. verwendete Suchbagriffe)
	EPO-In	ternal	
	C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
	Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile Beir. Anspruch Nr.
/	Y	US 2002/184172 A1 (GLEIBMAN ANDREW ET AL) 5. Dezember 2002 (2002-12-05) Absatz '0050! - Absatz '0051!	1-14
	Y	BREAUX L ET AL: "Automatic defect classification system for patterned semiconductor wafers" SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, 1995., IEEE/UCS/SEMI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUSTIN, TX, USA 17-19 SEPT. 1995, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 17. September 1995 (1995-09-17), Seiten 68-73, XP010193372 ISBN: 0-7803-2928-7 Abschnitt III Offline ADC Technology	1-14
	L^ entn	ere Veröflentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang ehmen	
	"A" Veröffe aber n "E" älteres Anmei "L" Veröffe schelr andere soll ot ausge "O" Veröffe	ntlichung, die den allgemeinen Sland der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist "tveföffentlichtung vor intlichung, die geelgnet ist, einen Prioritälsanspruch zweifelnaft eren zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer an im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beteigt werden und eine die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie mittlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	n besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung Ind dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf gkeil beruhend betrachtel werden In besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung erfinderischer Täligkeit beruhend betrachtel Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen In dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und
	'P' Veröffe	ntlichung die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	lür einen Fachmann nahellegend ist e Milgiled derseiben Palentfamille ist

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

28/12/2004 18. November 2004 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

Reise, F

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

1

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

PCT/	'EP2004/	051008
------	----------	--------

	······································			
C.(Fortsetz Kalegorie*	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Kalegorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, sowell erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspruch Nr.			
A	JÄHNE B: "Pixelverarbeitung" DIGITALE BILDVERARBEITUNG, Juni 2001 (2001-06), Seiten 257-295, XP002306421 SPRINGER VERLAG, BERLIN, DE ISBN: 3540412603 Seite 263 - Seite 264, Abschnitt "Nachweis von Unter- und Überlauf"	1,8		
Α	LI J ET AL: "Production use of an integrated automatic defect classification (ADC) system operating in a laser confocal/white light imaging defect review station"  ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CONFERENCE AND WORKSHOP, 1996. ASMC 96 PROCEEDINGS. IEEE/SEMI 1996 CAMBRIDGE, MA, USA 12-14 NOV. 1996, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 12. November 1996 (1996-11-12), Seiten 107-111, XP010204507 ISBN: 0-7803-3371-3 das ganze Dokument			
A	READING I ET AL: "Development of Automated Wafer Bump Inspection Technology" SIMTECH TECHNICAL REPORT, 2001, Seiten 1-6, XP002306422 Seite 3	•		